

이수페타시스 IR Material (하반기 NDR)

세계와 함께 성장하는 일류기업 이수페타시스
To be a World Wide Company ISUPETASYS



Disclaimer

본 자료는 투자자들에게 정보를 제공하기 위한 목적으로 ㈜이수페타시스(이하 "회사")에 의해 작성되었으며 임의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다.

본 자료의 열람 또는 수취는 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며, 제한 사항에 대한 위반은 관련 증권거래 법률에 대한 위반에 해당될 수 있음을 유념해주시기 바랍니다.

본 자료에 포함된 "예측정보"는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '기대', '(E)' 등과 같은 단어를 사용합니다.

위 "예측정보"는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은 "예측정보"에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

또한 향후 전망은 발표 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임직원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다.

본 문서는 주식의 매매를 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.

01



'24. 3분기 실적 Review

01. 연결 및 각 사별 실적추이
02. '24.3Q 실적 Review (페타시스 별도)
03. 신규 고사양 제품 대응 (가속기/800G)
04. 수주 현황(페타시스)

01 연결 및 각 사별 실적 추이

* 연결 : 24.3Q 매출 2,064억, 영업이익 259억 (페타시스 AI수요 강세 지속 / 미주법인 흑자 전환)

* 별도 : 24.3Q 매출 1,816억, 영업이익 202억 (AI가속기 수요 증가 및 네트워크 물량 회복에 매출 강세)

단위: 억원

구분		2023					2024				증감 (24.3Q)	
		1Q	2Q	3Q	4Q	합계	1Q	2Q	3Q	3Q누계	QoQ	YoY
페타시스	매출	1,419	1,435	1,455	1,481	5,790	1,684	1,742	1,816	5,242	4.2%	24.8%
	영업 이익	151	158	98	95	502	165	237	202	600	-14.8%	106.1%
중국법인	매출	281	280	320	338	1,219	368	372	338	1,078	-9.1%	5.6%
	영업 이익	45	29	45	33	152	58	51	34	143	-33.3%	-24.4%
미국법인	매출	103	86	88	79	356	99	86	46	230	-46.5%	-47.7%
	영업 이익	4	(6)	(11)	(25)	(38)	6	(10)	22	18	흑자전환	흑자전환
연결기준	매출	1,720	1,638	1,662	1,733	6,753	1,996	2,047	2,064	6,108	0.8%	24.2%
	영업 이익	202	182	132	106	622	230	275	259	764	-5.8%	96.2%

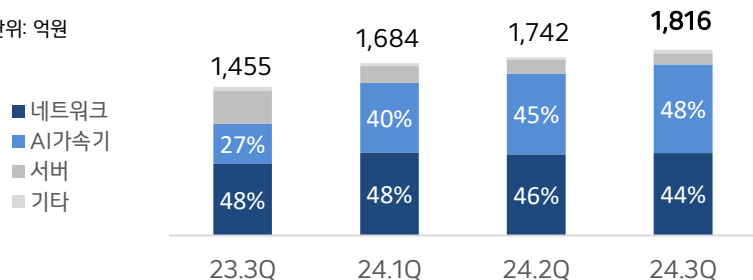
Cf. 연결실적 및 중국법인 금액은 감가상각비 조정(K-IFRS)을 포함한 수치임.

02 '24.3Q 실적 Review (페타시스 별도)

AI가속기 매출 증가 및 네트워크 물량 회복, 신규모델 초기 수율 저조 및 일회성 비용에 따른 손익 감소

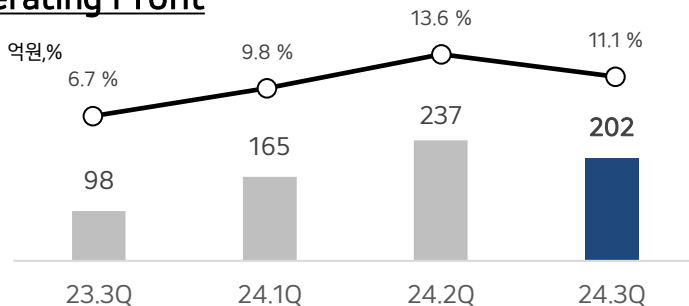
Sales

단위: 억원



Operating Profit

단위: 억원, %

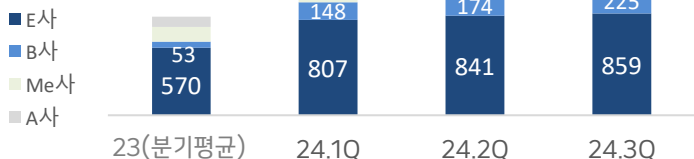


매출 증가 (QoQ +4.2% 증가)

- AI가속기(E사/B사) 및 네트워크(A사,Me사) 중심 매출 확대

[주요고객 매출 추이]

단위: 억원



주요 고객현황

주요고객	주요내용
E사	• 매출 AI가속기 증가 (2Q 614억 → 3Q 641억, +4.4% 증가), 스위치 증가 (2Q 173억 → 3Q 197억, +13.9% 증가)
B사	• 주력모델 매출 증가 (2Q 174억 → 3Q 225억, +29.3%) • 차기모델 신규 수주 진행 ('24.4Q~)
A사	• 24년 3Q 매출 67억 수준 (3Q 수주 증가로 4Q 매출 확대 전망) • 24년 3Q 수주 152억, 10월 수주 119억 (400G/800G 물량 증가)
Me사	• 매출 증가(400G) (2Q 144억 → 3Q 155억, +7.6%)

손익 특징 (QoQ -14.8% 감소)

- 데이터센터 고수익성 유지, 신규제품 수율 및 일회성 비용 반영으로 전분기대비 OP 2.7%p 하락

- 수익성 높은 E사/B사 매출 증가 → 수익성 개선
- 신규모델 초기 수율 저조 및 일부 저수익 제품 양산(이관 예정)

주요고객	주요내용
A사	• A사 다중적층 모델: 초도양산 수율 이슈로 인해 손익부진 → 수율 상승중 (초도양산 63% → 현재 84% 수준) ※ 전체 수율 평균 93%(E사/B사 95%), 수율 정상화시 영업이익률 20% 예상
M사	• M사 신규서버 모델 (VIPPO 공법 적용 제품) → 저수익 제품으로 초기 양산 후 이관 예정

③ 일회성 비용(3Q)

구분	주요내용
일회성비용	• 환경개선공사 진행_사무환경/지붕공사/복지관 등 : 26억원

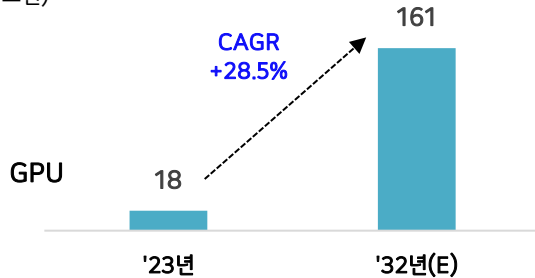
03 신규 고사양 제품 대응(가속기/800G)

AI가속기 및 고속 네트워크 시장 확대에 따른 가속기 및 네트워크 800G 스위치 물량 증가
 - 데이터 전송속도 고속화 및 신호손실 최소화에 따른 고객사 다중적층 제품 선호 ↑

AI가속기 시장

- GPU 시장 연평균 +28.5% 전망
- GPU 중심 수요 지속 증가 전망

(단위 : 조원)



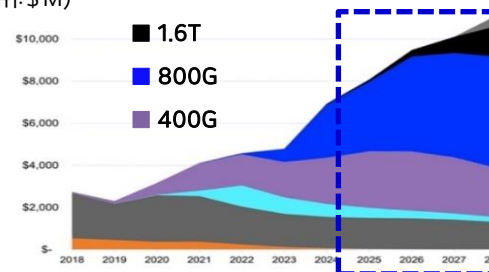
* 출처 : GMI(Global Market Insight)

고속 네트워크 시장

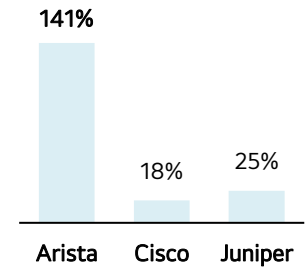
- AI 활용 증대, 네트워킹 부하 가중
- 800G 고성능 네트워크 교체 수요 증가

[네트워크 고객 매출 성장률, '20~'23년]

(단위:\$ M)



* 출처 : LightCounting, Internal Estimates



가속기 샘플 진행 현황

Category	Company	Status
Base보드	E사	• VIPPO(1종) : 주력제품 AI가속기 • 다중적층(2종) : '26년 예정
	B사	• VIPPO(3종) : 차기제품 1종 승인 • 다중적층(1종)
	M사	• VIPPO(1종) : 샘플 진행 중
	국내	• 다중적층(1종)
OAM	I사	• 다중적층(2종)

네트워크 800G 주요 진행 현황

- 고객사 다중적층 구조 선호 → 고객사 제품 양산
- 다중적층 샘플 수 증가 ('23년 132건 → '24년 206건 전망)

고객	샘플	양산	주요 사양
A사	19종	3종 진행	다중적층, 34/40L
N사	14종	'25.2Q(E)	VIPPO 28-36L
C사	13종	2종 진행	VIPPO 38L/44L
J사	8종	3종 진행	다중적층, 42-46L
Me사	7종	'25년(E)	다중적층

04 수주 현황(페타시스)

공장 증설 완료('24.3Q말) 이후 수주 증가 (AI가속기 E사, B사 중심 / 네트워크 A사, Me사 중심)

3개년 수주 추이('22~'24.3Q)

(단위:억원)

구분	'22년					'23년					'24년			
	1Q	2Q	3Q	4Q	계	1Q	2Q	3Q	4Q	계	1Q	2Q	3Q	계
금액	1,251	1,748	1,416	1,404	5,820	1,516	1,663	1,501	1,717	6,398	1,575	1,738	1,847	5,160
월평균	417	583	472	468	485	505	554	500	572	532	525	579	616	573

➢ 증설 이전('22.1Q) 수주평균 417억원/월 → 현재('24.3Q) 616억원/월 ▶ 증설이전대비 +47.7% 증가

최근 수주 추이('24.2Q~24년 10월)

(단위:억원)

구분	수주금액				내용(주요사항)
	주요고객	24.2Q	24.3Q	10월	
월평균 수주		579	616	791	· 10월 전월대비 수주 증감 · E사 298억 (전월대비 +28억), B사 102억 (-15억), A사 119억 (+65억), Me사 127억 (+51억)
AI 가속기/ 서버	E사	921	626	298	· 24.3Q 원자재 공급 이슈로 수주 일시적 감소, 4Q 대체 원자재 진행에 10월 수주 재상승세 / CAPA 할당 확대 · 10월 수주 증가 (스위치 물량 확대, 200억 이상)
	B사	153	336	102	· 24.6월부터 수주 증가세, 4Q CAPA 할당 확대 · 10월 신규 제품 오더접수 시작
네트워크	A사	52	152	119	· 데이터센터 호조에 따른 400G 대량오더 접수 및 신규 800G 스위치 양산 오더 접수 (모델 3종)
	Me사	208	200	127	· 주요 양산물량(400G,2종)물량 증가 및 신규 800G 샘플 대응 중 (분기 평균 200억원 수준 유지)

➢ '24.2Q 월평균 수주 579억원 → 24.3Q 616억원, 전분기대비 +6.4% 증가 (최근 3개월 수주, 8월 652억, 9월 676억, 10월 791억)

※ 중국법인_수주추이

(단위:억원)

구분	'22년					'23년					'24년			
	1Q	2Q	3Q	4Q	계	1Q	2Q	3Q	4Q	계	1Q	2Q	3Q	계
금액	361	388	332	316	1,397	238	248	286	354	1,126	331	324	338	1,043

➢ 최근 수주 : '24년 7월 102억으로 0사 신규 모델 변경에 따른 일시적 수주감소 영향, 최근 3개월 (8월 134억, 9월 152억, 10월 198억) 수주 재상승세 지속 중

02

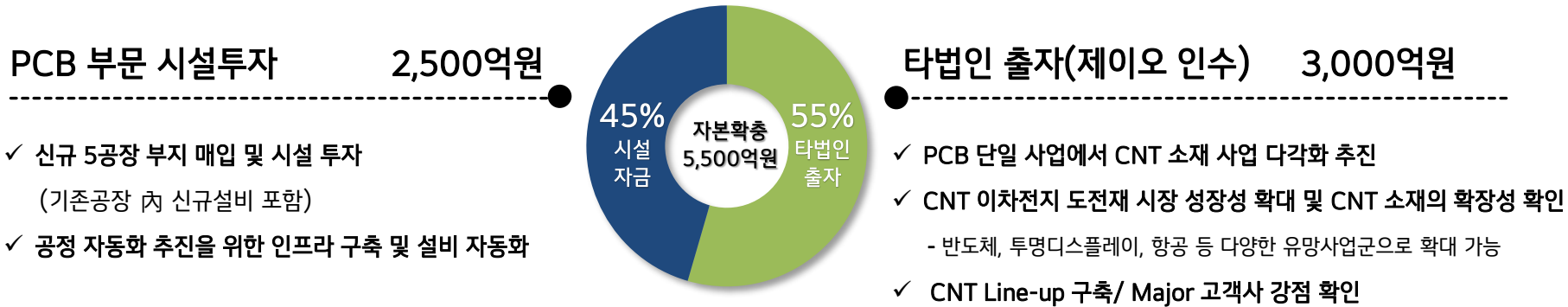


유상증자 관련 계획

- 01 유상증자 추진 배경
- 02 자금사용목적 (시설투자)
- 03 자금사용목적 (타법인 출자)
- 04 증자일정 등

01 유상증자 추진 배경

이번 증자는 미래 성장 동력 확보에 필요한 대규모 PCB 시설 투자 및 타법인 출자를 통한 중장기 성장 기반 강화가 목적입니다. AI 관련 PCB 기술변화 대응을 위한 시설투자(증설/신규 5공장 설립)를 통해 전방 수요 증가에 선제적 대응을 하고자 하며, 성장성 높은 CNT 소재 사업 진출을 위해 타법인출자를 통해 사업다각화 추진하고자 합니다.



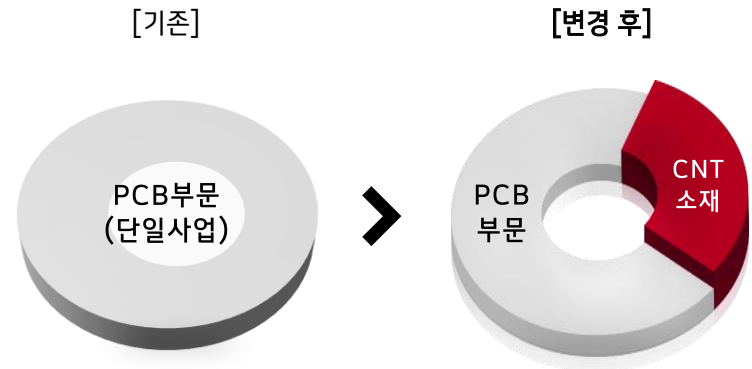
• 시설 자금 (4,000억원)

- 유상증자 : 2,500억원 / 내부 보유 예금 등 : 1,500억원

• 향후 사업 포트폴리오 강화

[자금 사용 계획]

구 분	1차 투자	2차 투자
투자 방향	현 공장 (1~4공장)	신규 5공장
투자 시기	'25년 (12개월)	'26년~'28년 (36개월)
투자 비용	800억	3,200억
합 계	총 4,000억원	



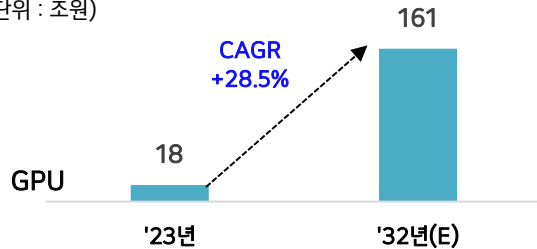
02 자금사용목적(시설투자)_1)전방시장 및 PCB 기술변화

AI용 데이터센터의 연산처리 용량 급증 및 데이터 전송속도 고속화 요구 확대에 맞춰 PCB 기술 트렌드가 변화되고 있습니다. '25년 부터 주요 데이터센터 고객들의 신기술 적용 제품의 출시가 가시화 되고 있습니다.

AI가속기 시장

- GPU 시장 연평균 +28.5% 전망
- GPU 중심 수요 지속 증가 전망

(단위 : 조원)

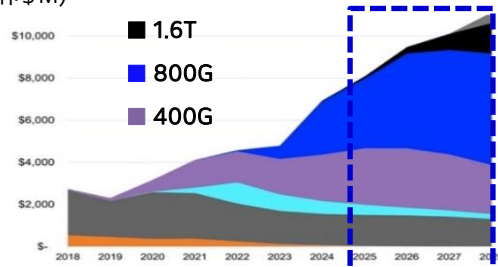


* 출처 : GMI(Global Market Insight)

고속 네트워크 시장

- AI 활용 증대, 네트워킹 부하 가중
- 800G 고성능 네트워크 교체 수요 증가

(단위:\$M)



* 출처 : LightCounting, Internal Estimates

기술변화 및 주요 고객

- 고객사 다중적층 구조 선호 → 고객사 제품 양산 ('24~'26년)

구분	기존	변화	주요고객 (양산시기,E)
AI가속기	일반 MLB (VIPPO)	➔	E사, B사, I사 등 ('25~'26년)
800G			다중적층 (HDI, *IVH)

※ IVH (Inner Via Hole) : 기존 비어홀 대비 임의의 층간만 전기적 접속으로 배선길이 짧고 신호속도 증가효과

- 제품 구조/기술변화 사유

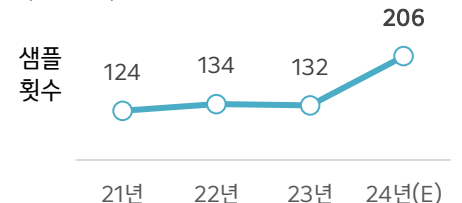
1) 고속 데이터 전송속도 향상 필요 및 PCB 부품 실장 면적 확보

2) 필요 층간 연결을 통한 신호손실 최소화

- 당사 다중적층 샘플 진행 현황

- '24년 전년比 약 2배 이상 증가 전망

(단위 : 건)



02 자금사용목적(시설투자)_2)기술변화에 따른 CAPA 변동 및 투자 방향

고객사 신기술 적용(다중적층 구조)에 따라 당사 PCB 공정(적층/도금/외층 등) 부하로 CAPA Loss가 전망됩니다.
 시설투자는 총 4,000억원 규모로 1단계 800억원, 2단계 3,200억원을 통해 CAPA 확대를 목표하고 있습니다.

다중적층 변화로 PCB 공정부하 증가(Capa Loss)

- 고객사 다중적층 구조 선호

구분	일반 MLB	다중적층	
		Sequential 타입	HDI 타입
PCB 구조	1회	<ul style="list-style-type: none"> • 불필요 경로 삭제 	<ul style="list-style-type: none"> • 신호 거리 단축
	APP	Server	Server / Data center



- PCB 공정 프로세스 증가

- 복잡하고 긴 프로세스로 특정공정 부하 가중 (적층/도금 외)

공정	일반 MLB	다중적층	공정부하
적층	1회	3~4회	3~4배 ▲
도금	5회	7~9회	2배 ▲
외층	2회	7회	3배 ▲
메꿈	1회	3회	3배 ▲

※ 고객별 모델에 따라 Sequential + HDI 타입도 존재

단계별 시설투자 약 4,000억원 규모

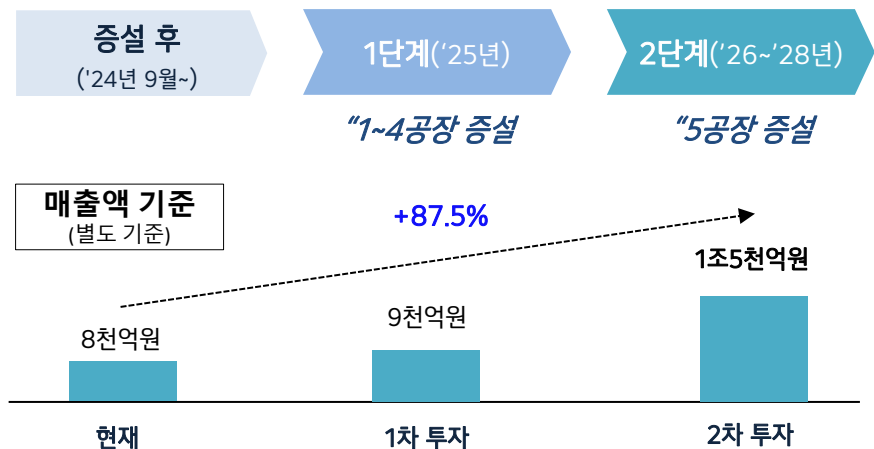
- 단계별 투자를 통한 최대 CAPA 확대 전망

[단위 : 억원]

구분	현재	단계별 투자계획		
		1단계	2단계	합계
투자시기	~'24.9월말	'25년 (12개월)	'26~'28년 (36개월)	
해당부지	-	1~4공장	5공장	
투자금액	1,240	800	3,200	4,000



- 투자 계획



03 자금사용목적(타법인출자)_1)인수배경 및 인수구조/지분율

기존 PCB 단일 사업에서 CNT 소재 사업 진출로 사업다각화를 통해 성장성을 강화하고자 합니다.
 총 인수금액은 3천억원으로 인수 후 지분율은 33.3% 입니다. 신주/CB 대금은(약1.4천억원) 사내에 유보되어
 향후 추가 성장 재원으로 활용될 예정입니다.

인수 배경

- ✓ PCB에 집중된 사업구조 다각화
 - 편중된 전방시장 탈피, 외형 확장에 따른 성장성 강화
 - 성장가능성 높은 이차전지 소재 사업 진출

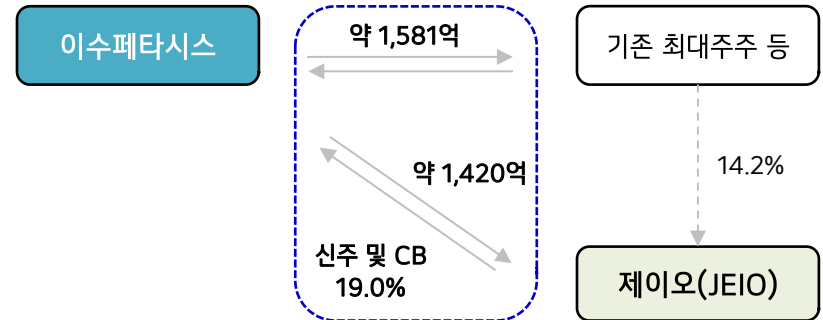
회사 개요

회사명	제이오(JEIO)
시가총액	7,434억원 ('24.06.28 종가 기준)
회사설립	'94.11월 설립 ('23.2월 코스닥 상장)
실적 ('23년)	매출액 1,145억원, 영업이익 120억원 - CNT 부문 273억원 (24%)
CAPA	MW(양극재용)기준 CNT 2,000톤/연간 - 국내 2위, 글로벌 5위권

※ CNT(Carbon nanotube, 탄소나노튜브)
 - 얇은 탄소 박막의 원통형태로 전기.열전도율이 높고 강도는 철강의 약 100배 수준, 배터리와 반도체, 자동차 부품, 항공기 동체 등 폭넓게 사용되고 있음.

인수구조 / 지분율

인수구조



※ 1) 기존 최대주주의 575만주(발행주식총수의 18.1%) 인수
 2) 신주/CB 약 1.4천억원은 사내 투자재원으로 활용 예정

지분율 변화

(단위 : 백만주, %)

구분	기존		지분인수 후	
	주식수	지분율	주식수	지분율
기존 최대주주	11.4	36.0%	5.7	14.2%
이수페타시스	-	-	13.4	33.3%
기타주주	19.3	60.7%	21.0	52.5%
발행주식 총수	31.7	100%	40.1	100%

※ 구주/신주/CB 전환 후 기준으로 지분율 33.3%임

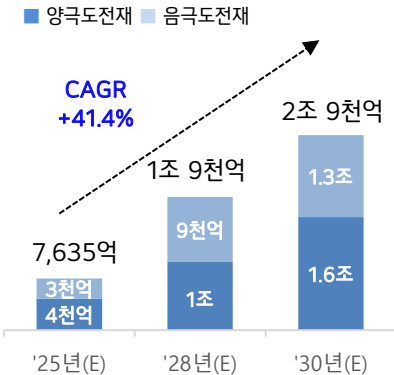
03 자금사용목적(타법인출자)_2)CNT시장 및 회사 성장성

CNT 시장 성장은 연평균성장률 41.4 %로 급성장이 예상되고, 이차전지 도전재 외 다양한 분야(반도체, 디스플레이, 항공 등)의 부품 및 소재로 활용가치가 높을 것으로 전망됩니다. 제이오는 기술 경쟁력을 갖춘 회사로, 완성된 CNT Line-up을 기반으로 안정적인 Major 고객을 확보하고 있습니다.

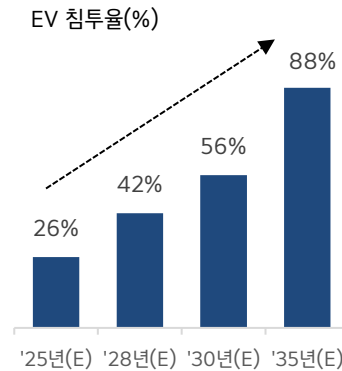
CNT 시장 전망

- CNT 도전재 시장 성장성 확대 (향후 7개년간 CAGR 41.4% 전망)

[글로벌 CNT 시장]



[글로벌 EV 시장]



* 출처 : SNE Research

- 당사 시장조사 결과(리서치 등), CNT 수요확대 가능성이 높을 것으로 전망

- 이차전지 도전재가 Key-driver로 작용
 - 현재 LIB(리튬이온배터리) CNT시장 규모 약 7천억원 추산
- 향후 투명디스플레이, 반도체 노광장비 펠리클, 항공동체 등의 소재로 적용될 전망

제품	내용	CAGR
MW	'23년 약 1만톤 → '30년 6.7만톤 추산	+29%
SW	'23년 약 30톤 불과 → '30년 약 1만톤 규모로 확대	+129%

제이오 기술력 및 고객사

- CNT Full Line-up 구축(MW, TW 제이오 only, SW개발완료)

	Multi-wall 탄소나노튜브	Thin-wall 탄소나노튜브	Single-wall 탄소나노튜브
제이오 브랜드명	JENOTUBE 10B	JENOTUBE 6A	JENOTUBE 3A
벽 개수	8개 이상	3~5개	단일벽
적용 대상	양극재용	양극·음극재용	음극재용
특성	이차전지 에너지 밀도 향상 제이오 (세계 최초 비철계 CNT), A, B, C사 등	양극·음극용 도전재 특성 극대화 제이오 ONLY	실리콘 음극 활용질 안정성 확보 제이오(개발완료), D사

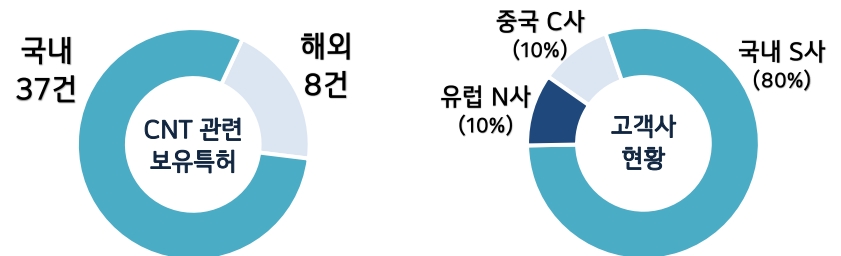
* 출처 : 제이오(JEIO)

- ✓ 현재 주력 제품은 MW인 양극재용 '10B' 및 TW인 음극재용 '6A'
- ✓ 향후 실리콘음극재에 적용될 SW 제품 '3A'는 개발완료 및 고객사 샘플 Test 중

- 특허등록 / 고객사 현황

- '05년부터 총 65건 출원 & 45건 등록

- 현 고객사 외 글로벌 셀사 신규고객 추진 중



03 자금사용목적(타법인출자)_3)향후 운영방안

개화단계인 CNT 시장 선도업체로서 기술력을 바탕으로 향후 지속적인 성장을 추구하고자 합니다.
향후 CAPA 증설 및 신규 반도체 소재산업(반도체 펠리클용 CNT 개발 등) 다양한 응용 분야 진출을 고려하고 있습니다.

CNT 분야 선도업체 유지

- 시장상황에 따라 CAPA 증설 검토 (현재 2,000톤/연간)
 - ① 2공장 토지/건물 완료, 설비 추가에 따른 +1,000톤/연간 증설 가능
 - 비용 약 350억원 추정 (회사 보유자금 Cover 가능)
 - ② 사내유보자금(신주/CB대금) 약 1,400억원 추가 시설투자 검토
 - 시장 및 경쟁사 현황 등을 고려하여 고객요구 대응 예정

구분	주요내용		
공장	제1공장	제2공장	합계
CAPA(현재)	1,000	1,000	총 3,000톤/연간
설비투자 시	-	1,000	

※ MW 양산시기 '06년, TW '14년

※ 경쟁사 동향

구분	국내		해외
	L사	JEIO	C사
現 Capa	2,900톤/年 (MW 기준)	2,000톤/年 (MW 기준)	4,000톤/年 (MW 기준)

반도체 소재산업(펠리클용 CNT) 진출 모색

- CNT 펠리클 개발 컨소시엄 참여 등 CNT Application 확대 가능

[CNT 물성 특징]



✓ 반도체 *펠리클 및 투명 디스플레이 등 활용 (매우 작은 직경)

※ 펠리클(Pellicle): 반도체의 노광공정(EUV)에서 사용되는 포토마스크를 이물질 오염으로부터 보호하기 위한 박막, '덮개' 역할



※ 세대별 주요 소재

세대별 노광장비	반도체 노드	펠리클 주요 소재	빛 투과율
1세대, DUV	~ 10 nm	Polymer	85%
2세대, EUV	~ 5 nm	메탈 실리사이드 (Me-Si)	90%
3세대, High NA EUV	~ 3 nm	CNT	95%

- CNT, 빛 흡수율이 낮고 빛 투과도 높음 → 발열 낮음
- 기존 메탈실리사이드(Me-Si) 대비 기계적 강도 우수 → 수명 길어짐



➤ 차세대 EUV 펠리클용 CNT 멤브레인 기술 개발 착수 ('24년 10월)

04 증자 개요

주주배정 후 실권주 일반공모로 진행되며, '2025년 2월 내 신주 상장을 목표로 하고 있습니다.

발행개요

구분	내용
증자방식	• 주주배정 후 실권주 일반공모
예정 발행규모	• 5,498억원
신주발행주식수	• 2,010만주
증자비율	• 31.79%
1주당 액면가액	• 1,000원
예상 발행가액 ^{주1)}	• 27,350원
할인율	• 15%
우리사주 배정비율	• 3%
대표주관회사	• NH투자증권
인수회사	• 신한투자증권/신영증권
자금사용목적(예정)	• 시설자금(2,500억원) • 타법인증권취득(3,000억원)

※ 상기 발행개요는 변동 가능

주요일정

구분	일자
이사회결의 및 주요사항보고서 제출	2024-11-08 (목)
증권신고서 제출	2024-11-18 (월)
1차 발행가액 결정	2024-12-12 (목)
증권신고서 효력 발생	2024-12-13 (금)
신주배정기준일	2024-12-17 (화)
신주인수권증서 상장기간	2025-01-17(금) ~ 2025-01-23(목)
신주인수권증서 상장폐지	2025-01-24 (금)
최종발행가액 확정	2025-02-03 (월)
우리사주 청약	2025-02-06 (목)
구주주 청약	2025-02-06(목) ~ 2025-02-07(금)
일반공모 청약	2025-02-11(화) ~ 2025-02-12(수)
주금 납입	2025-02-14 (금)
신주상장일	2025-02-28 (금)

※ 상기 일정은 변동 가능

03



Appendix

- 01 각 사별 개요 및 실적추이
- 02 Global PCB 업체 순위
- 03 Global IT 업체 고객사 다수 확보
- 04 차별화된 기술력 및 Capa 확대로 성장기반 구축

01 각 사별 개요 및 실적추이

개요

설립년도/주요제품

실적추이(매출/영업이익)

* 연결기준 '20~'23 매출 CAGR 10% (페타 별도 20%)

ISU Petasys (Korea)



- 1989년, 한국(대구)
- **초고다층 (20L↑)**
- App.
 - 시가속기
 - 네트워크/서버 장비

ISU petasys Hunan (China)



- 2013년, 중국(상탄)
- **중다층 (~18L)**
- App.
 - 네트워크/서버 장비
 - 전장

ISU petasys Corp (USA)



- 2001년, 미국(CA)
- **영업법인**
(생산부문 정리, '24년)

구분	'20	'21	'22	'23	'24.3Q (누계)	
페타시스	매출	3,351	3,635	4,972	5,790	5,242
	영업이익	222	437	964	502	600
중국법인	매출	509	921	1,427	1,219	1,078
	영업이익	(107)	24	203	152	143
미국법인	매출	292	322	371	356	230
	영업이익	(36)	8	(6)	(38)	18
연결기준	매출	5,142	4,696	6,429	6,753	6,108
	영업이익	20	469	1,166	622	764

02 Global PCB 업체 순위

Global 1위

(국내 MLB PCB 매출 1위)

> 고다층 PCB(18층 이상) 제조사 중 Global 매출 1위

2022년 18층 이상 PCB 업체 매출 순위
(Prsimark VHMLB PCB Market Share)

Rank	Company	18L층 이상 매출(M\$)
1	ISU Petasys (Korea)	374
2	WUS (Taiwan)	252
3	TTM (US)	239
4	Shennan (China)	175
5	Gold Circuits (Taiwan)	117
6	Tripod (Taiwan)	64
7	Sanmina (US)	59
8	Shengyi (China/HK)	57
9	Yamamoto (Japan)	55
10	Yamamoto	60
11	Others	235

Top 10 Total 1,687

World Top PCB makers in 2022

Rank	Company	Sales (M\$)
1	Zhen Ding	4,835
2	Unimicron	3,342
3	Dongshan	3,270
4	Nippon Mektron	2,479
5	TTM	2,233
6	Compeq	2,146
7	Tripod	1,919
8	Shennan	1,820
9	AT&S	1,631
10	Kinwong	1,498
39	ISU Petasys	516

Top 10 Total 53,469

*Source : Prismark Report(2023.07)

*VHMLB : Very High Multi Layer Boards

03 Global IT 업체 고객사 다수 확보

신규고객 다수 확보

Global IT업체 중심 신규 고객 확보로 포트폴리오 다변화

AI 가속기 및 고속 네트워크 성장 산업의 신규 Major 고객 확보

고객 포트폴리오 다변화(별도기준)

* 매출 100억/년 이상 고객사: '17년 4개사 → '23년 9개사로 확대

구분		2017	비중	2023	비중
데이터센터	E사	317	11%	1,869	32%
	B사	-	-	239	4%
	Me사	103	3%	563	10%
	I사	-	-	102	2%
	기타	-	-	75	2%
	소계	420	14%	2,848	50%
네트워크	A사	94	3%	371	6%
	C사	1,043	35%	587	10%
	N사	580	19%	436	8%
	O사	98	3%	68	1%
	J사	35	1%	755	13%
	E사	-	-	409	7%
	기타	747	25%	316	5%
	소계	2,597	86%	2,942	50%
	합계	3,017	100%	5,790	100%

글로벌 주요 업체



04 차별화된 기술력 및 Capa 확대로 성장기반 구축

46.7%
(투자 후 Capa 증가율%)

신공장 증축 및 자동화 투자로 MLB 생산 경쟁력 강화

납기 단축으로 신규 제품 샘플 대응 및 추가 수주 확대 전망

선도적인 기술력 및 품질

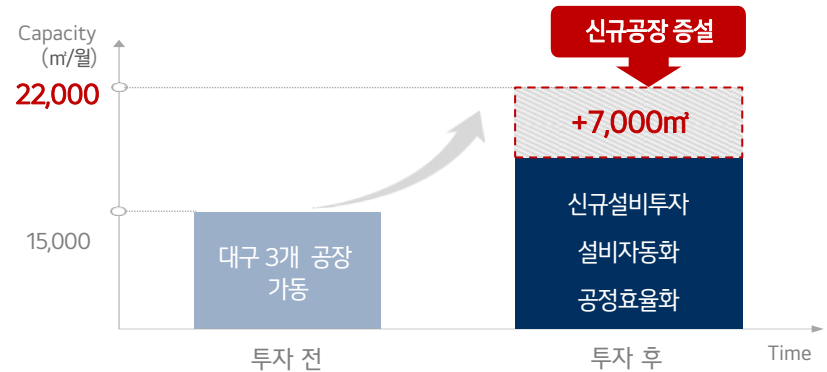
· 핵심 공정에 대한 높은 제조 기술력 보유

핵심 공정	기술 구분	기술 수준	
		자사	타사
적층/회로	적층 및 고정밀 정합 기술	44L (반도체 Test용 100L 수준)	28L 이하
도금	고정밀 도금 고정밀 홀가공	25 : 1 ± 3mil	15 : 1 ± 8mil
홀가공	고난이도 홀메꿈	25 : 1	20 : 1
원자재개발	신호 고속화 측정	Ultra low Loss material (Df<0.002)	Mid loss material (Df<0.01)

※ 최근 기술 트렌드: 제품 두께 상승 및 높은 도금 능력 요구 증가
고정밀 도금 제품↑: 16:1이상 제품 매출 증가 ('21년 39천㎡ → '23년 51천㎡)

Capa 투자 완료('24.3Q말)

① Capa 확대 (매출기준 '22년 412억/월 → '24.4Q 650억/월 (E))



② 생산 리드타임 축소

- 고객 납기 기존 16~20주 → 변경 8~10주('24.4Q)
- 신규 제품(800G/OAM) 샘플 및 양산 시간 최소화
ex) 다중적층 6~7주 → 4.5~6주 대응

End of Document